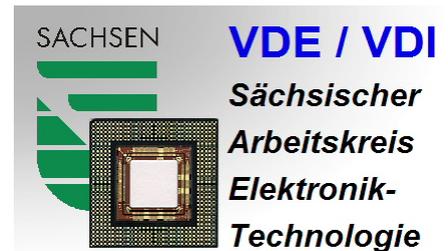


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)
01069 Dresden
e-mail: bauer@et.htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann
Technische Universität Dresden
Zentrum für mikrotechnische Produktion
01062 Dresden
e-mail: oppermann@zmp.et.tu-dresden.de



Informationen zum Arbeitskreis im Internet:

<http://www.avt.et.tu-dresden.de/SAET/>

39. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

Thema: *Nacktchipmontage und Löten beim Microelectronic Packaging*

Gastgeber: Microelectronic Packaging Dresden GmbH (www.mpd.de)

Ort: Grenzstraße 24, 01109 Dresden

Datum: 24. März 2004 10:00 Uhr

Agenda:

- 10:00 Uhr Begrüßung
Herr Ludewig – MPD, Herr Prof. Bauer – HTW
- 10:05 Uhr Vorstellung der Fa. Microelectronic Packaging Dresden GmbH
Herr Pulver – MPD
- 10:30 Uhr Aktuelle Trends und Anforderungen des Microelectronic Packagings
Herr Schneider – MPD
- 11:15 Uhr *Kaffeepause*
- 11:30 Uhr Vollautomatisierte Reworkprozesse
Herr Sommerfeld, Herr Pietrzak – ZEVAC GmbH, Oberpfammern
- 12:15 Uhr *Mittagspause*
- 13:00 Uhr Neuigkeiten aus der Röntgentechnik - von 2D bis Tomographie
Herr Sommerfeld, Herr Pietrzak – ZEVAC GmbH, Oberpfammern
- 13:30 Uhr Löten auf Packaging-Niveau
Herr Schneider – MPD
- 14:00 Uhr Einsatz eines UV-Inspektionsgerätes für organische Schichtmaterialien in der Mikroelektronik
Herr Ronniger – KARO Electronics Vertriebs GmbH, Dorfen
- 14:30 Uhr Abschlussdiskussion und Organisatorisches
Herr Prof. Bauer – HTW, Herr Dr. Oppermann – TUD
- 14:45 Uhr *Fertigungsbesichtigung MPD*

Alle Interessenten sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Anmeldungen sind bis eine Woche vor der Veranstaltung an Herrn Prof. Bauer oder Herrn Dr. Oppermann (Email-Adressen: siehe oben) zu senden.